
2012年3月期業績予想と 今後の経営方針

代表取締役社長 竹中 博司

2011年5月13日



2011年3月期レビュー



2011年3月期 業績

	2010年3月期	2011年3月期	対前年増減
売上高	4,186億円	6,687億円	+59.7%
営業利益	▲21億円	978億円	+1,000億円
営業利益率	▲0.5%	14.6%	+15.1pts
税前利益	▲77億円	995億円	+1,073億円
当期純利益	▲90億円	719億円	+809億円
1株当り配当金	12円	114円	+102円

2011年3月期 成果

- ▶ 売上高 前年比59.7%増加の6,687億円
- ▶ 営業利益 前年比1,000億円増加の978億円
- ▶ 収益性が改善
 - 売上総利益率： 35.1%
 - SPEセグメント税前利益率： 23.6%
- ▶ 研究開発費 過去最高の705億円
- ▶ 営業キャッシュ・フロー 832億円創出
- ▶ 製造拠点戦略の実行
 - 宮城新工場着工
 - 中国江蘇省昆山に工場新設を決定

2011年3月期 新製品

高プロセス性能、高生産性、省電力対応の新製品を市場投入

- ・ 新プラズマエッチング装置 “Tactras™ RLSA™ Etch”
- ・ 高生産性バッチALD-SiN装置 “TELINDY PLUS™ IRad™ SA”
- ・ 枚葉プラズマ酸化・窒化処理装置 “Trias™ e+ SPAi”
- ・ ガスケミカルエッチング装置 “Certas WING™”
- ・ SiCエピタキシャル膜成長装置 “Probus-SiC™”



Tactras™ RLSA™ Etch



TELINDY PLUS™ IRad™ SA



Trias™ e+ SPAi



Certas WING™



Probus-SiC™

市場環境



CY2011 事業環境

▶ 半導体設備投資

震災の影響を受け、上期は当初予想を若干下回るが、下期は増加を見込む
NAND、ロジック/ファウンドリー向けは好調に推移しており、通年では従来通り
10%の増加を予想

▶ FPD設備投資

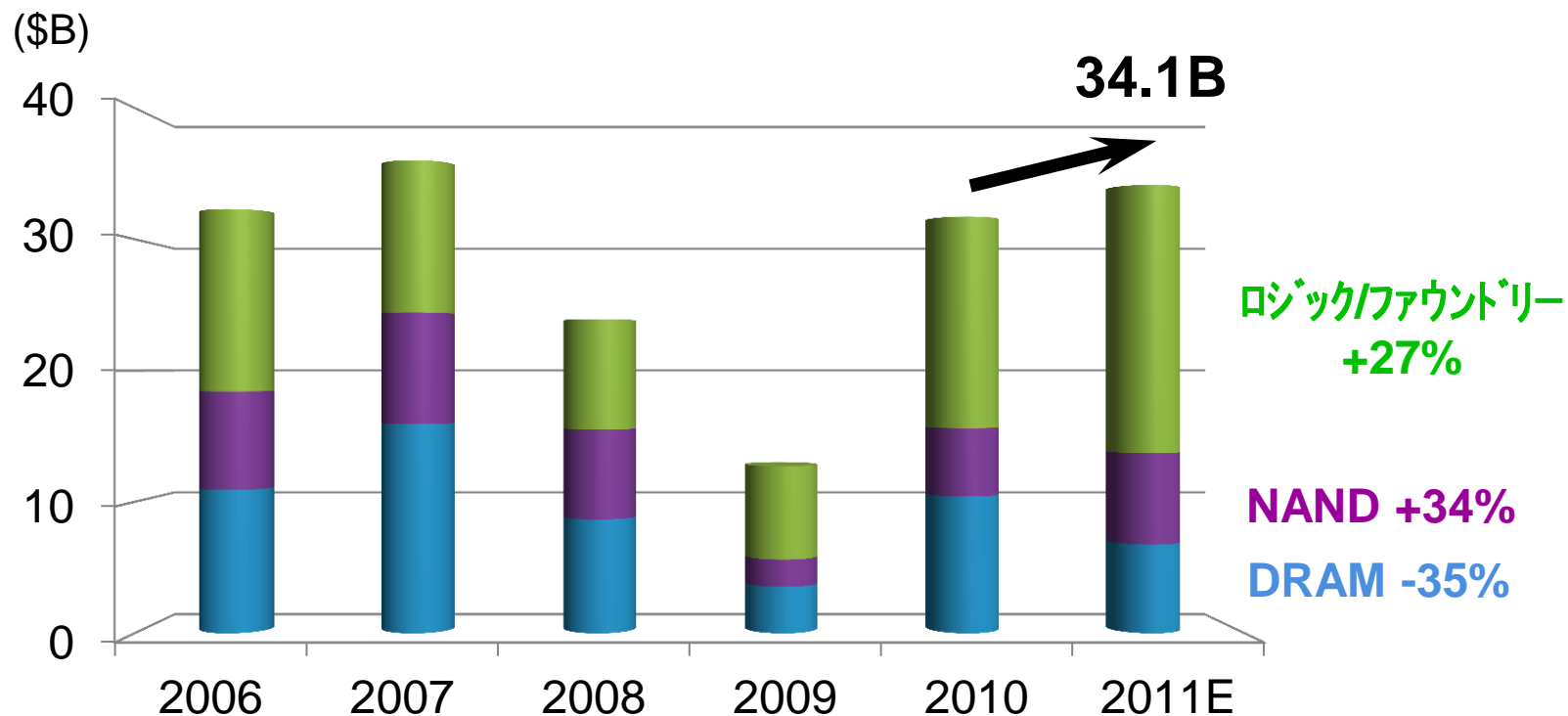
大型パネル向け投資は調整も、スマートフォンなどの中小型向け投資は伸長し、
全体としては前年とほぼ同程度を見込む

▶ PV設備投資

現時点では、単結晶シリコン系や化合物(Cd-Te)系が好調を維持
一方、薄膜シリコン系は、変換効率等の改善により将来性に期待

FPD: フラットパネルディスプレイ PV: 太陽電池

CY2011 アプリケーション別前工程設備投資



NANDとロジック/ファウンドリー向け投資が拡大

出所: Gartner Dataquest, TEL

8

四半期 受注額

(億円)

3,000

2,500

2,000

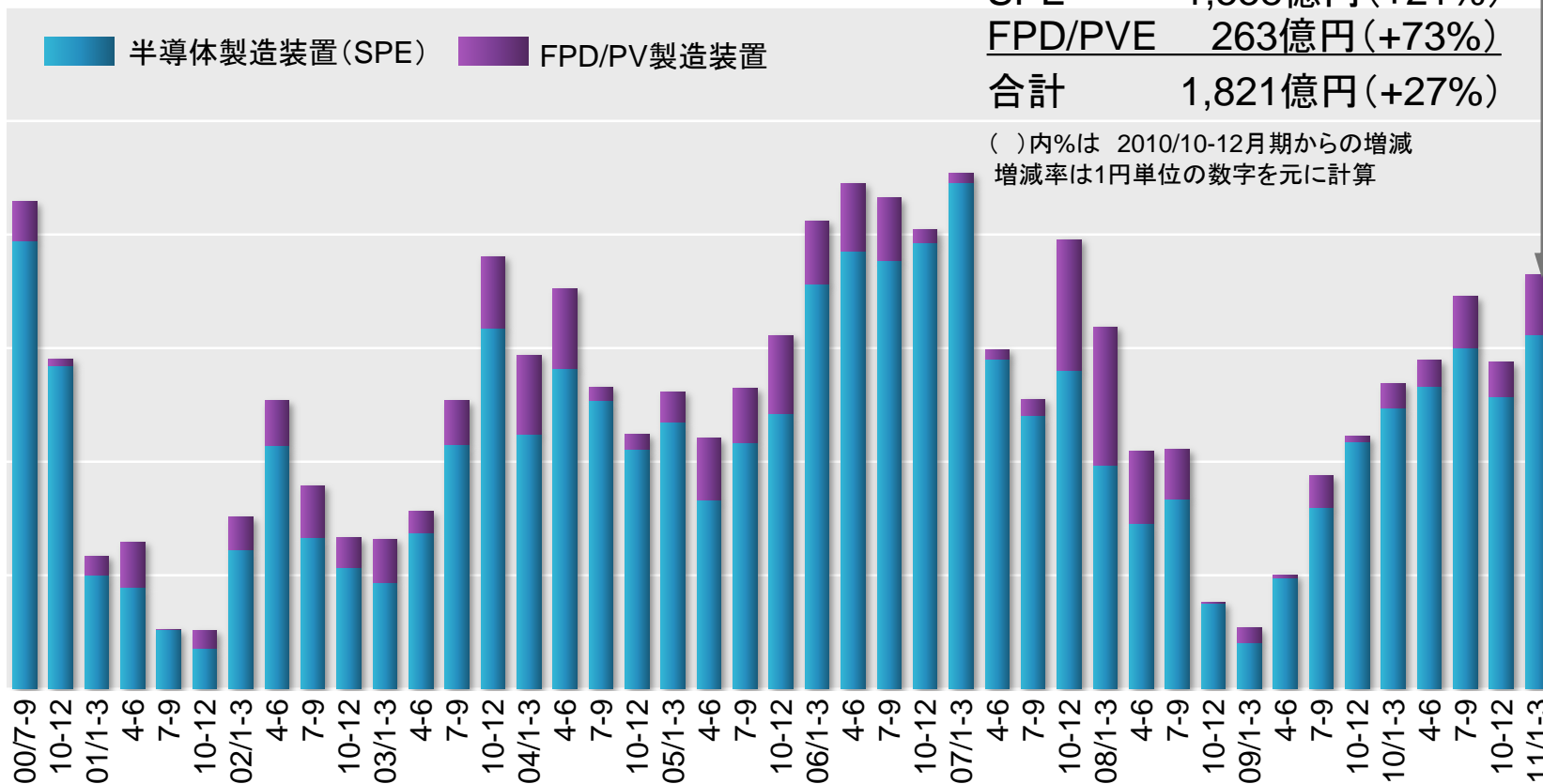
1,500

1,000

500

0

■ 半導体製造装置(SPE) ■ FPD/PV製造装置



2011/1-3月期

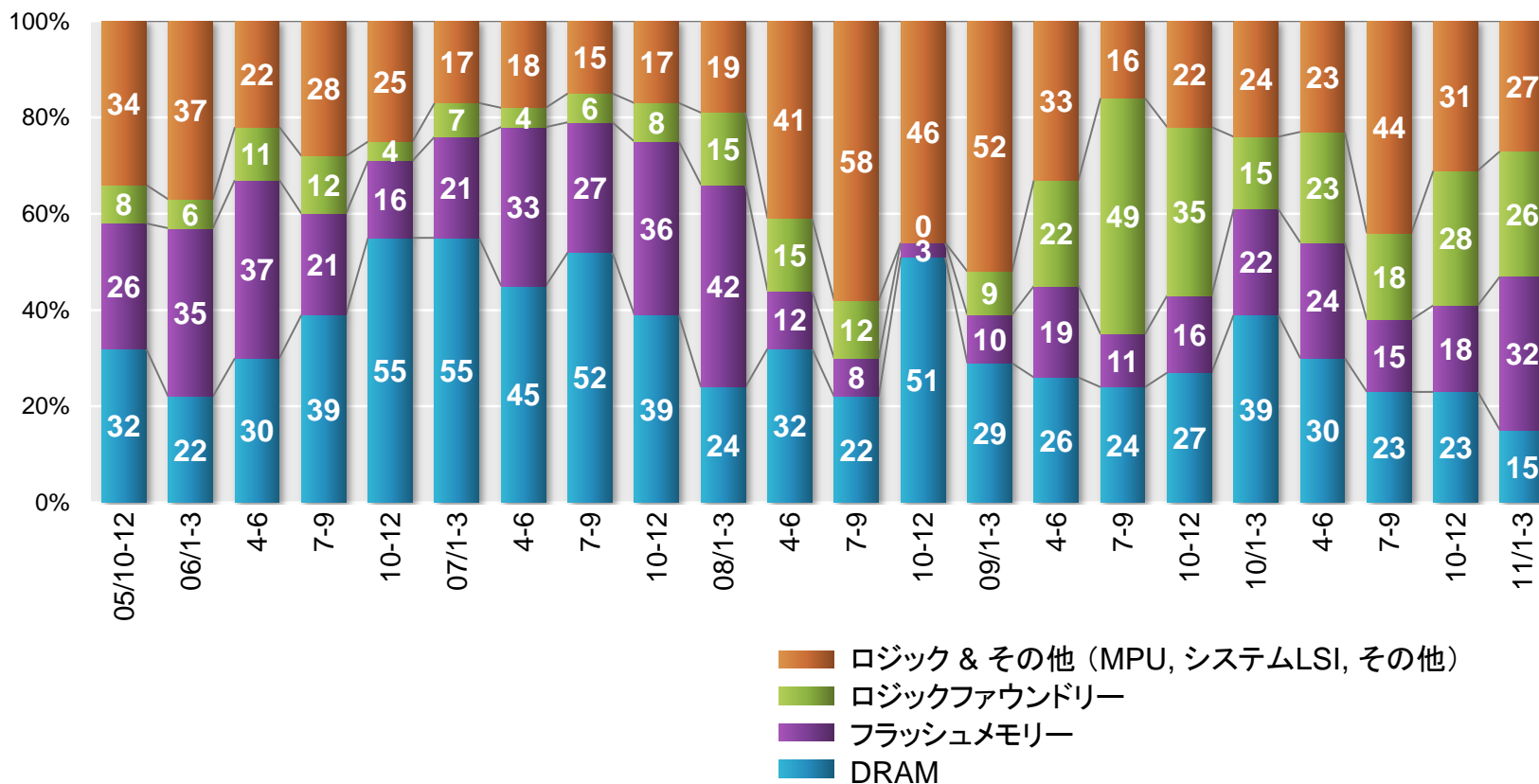
SPE 1,558億円(+21%)

FPD/PVE 263億円(+73%)

合計 1,821億円(+27%)

()内%は 2010/10-12月期からの増減
増減率は1円単位の数字を元に計算

四半期 アプリケーション別SPE受注

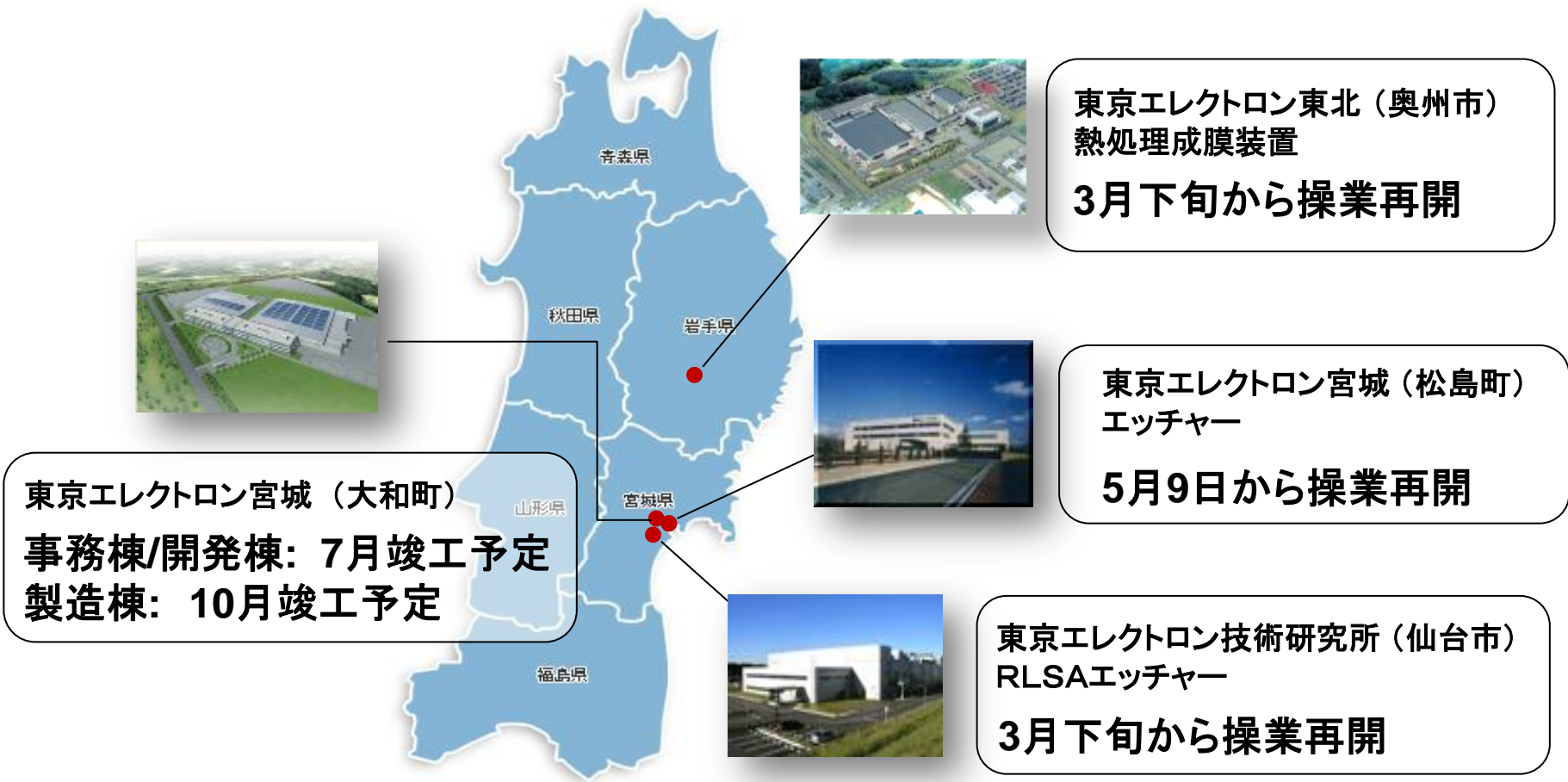


グラフは装置本体受注における構成比を示しています

2012年3月期 業績予想



東日本大震災からの復旧状況



東北地域の全ての工場が操業を再開

震災対応

サプライヤー

- 東北6県+茨城県：約300社の状況を把握
- 当社工程調整および一時的な代替生産等で対応

放射能

- 海外へ出荷する全ての装置およびパーツを測定
- 国際航空運送協会 (IATA) の規定に準拠

電力

- 今夏計画：昨年ピーク比25%減
- 太陽光発電(2000KW)、ターボ冷凍機、非常用発電機およびシフト勤務により対応

2012年3月期 業績予想

(億円)

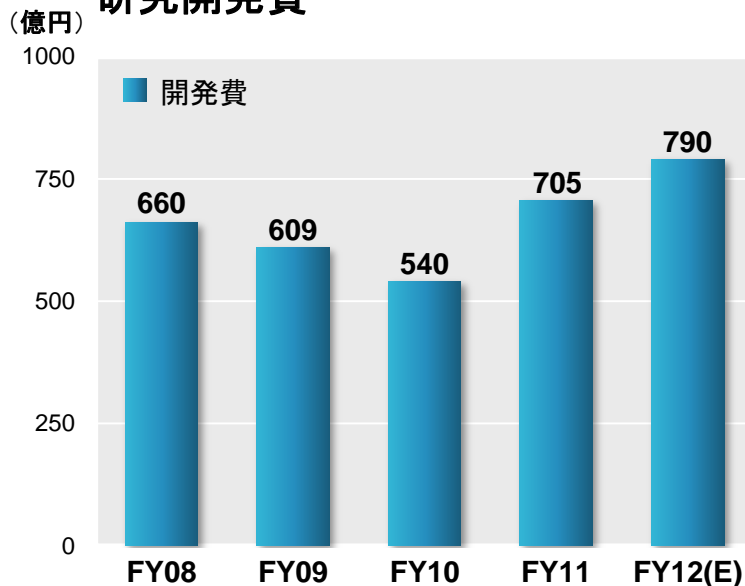
	FY2011	FY2012 (予想)			
		上期	下期	通期	対前年増減
売上高	6,687	3,350	3,950	7,300	+9%
SPE	5,113	2,530	3,060	5,590	+9%
FPD/PVE	667	380	380	760	+14%
EC/CN	902	440	510	950	+5%
その他	4	-	-	-	-
営業利益	978 14.6%	350 10.4%	650 16.5%	1,000 13.7%	+21 -0.9pts
税前利益	995	360	660	1,020	+24
当期純利益	719	230	430	660	-59
1株当たり当期純利益 (円)	401.7	128.5	240.1	368.6	-33.1

1. SPE: 半導体製造装置, FPD/PVE: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池製造装置, EC/CN: 電子部品/コンピュータ・ネットワーク
2. 利益率及び増減率は、1円単位の金額をもとに計算しています。

上期は震災影響が若干あるものの、通期では売上、営業利益増

研究開発費・設備投資計画

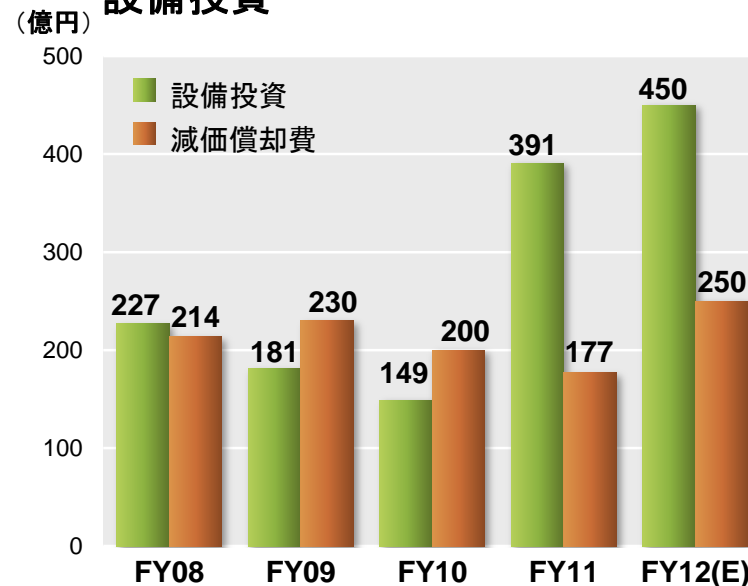
研究開発費



FY12(E)の主な研究開発費

- 既存分野 約60%
 - 新規分野 約40%
- (RLSAアプリ拡大、3DI, 有機EL, テスト、PV他)

設備投資



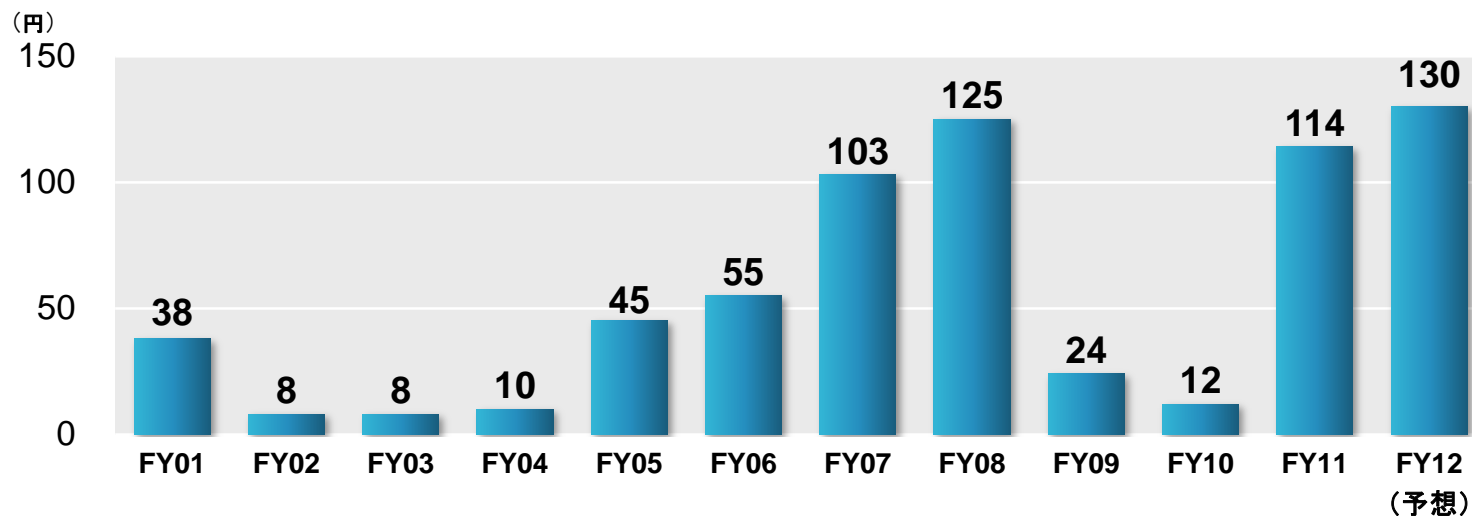
FY12(E)の主な設備投資計画

- 宮城新工場
- 中国 昆山新工場
- プロセス技術センター (韓国)
- 東京エレクトロンテクノロジーセンターつくば
- 機械装置/測定器

投資増のうち、新工場、新規分野へ120億円

当期配当予想

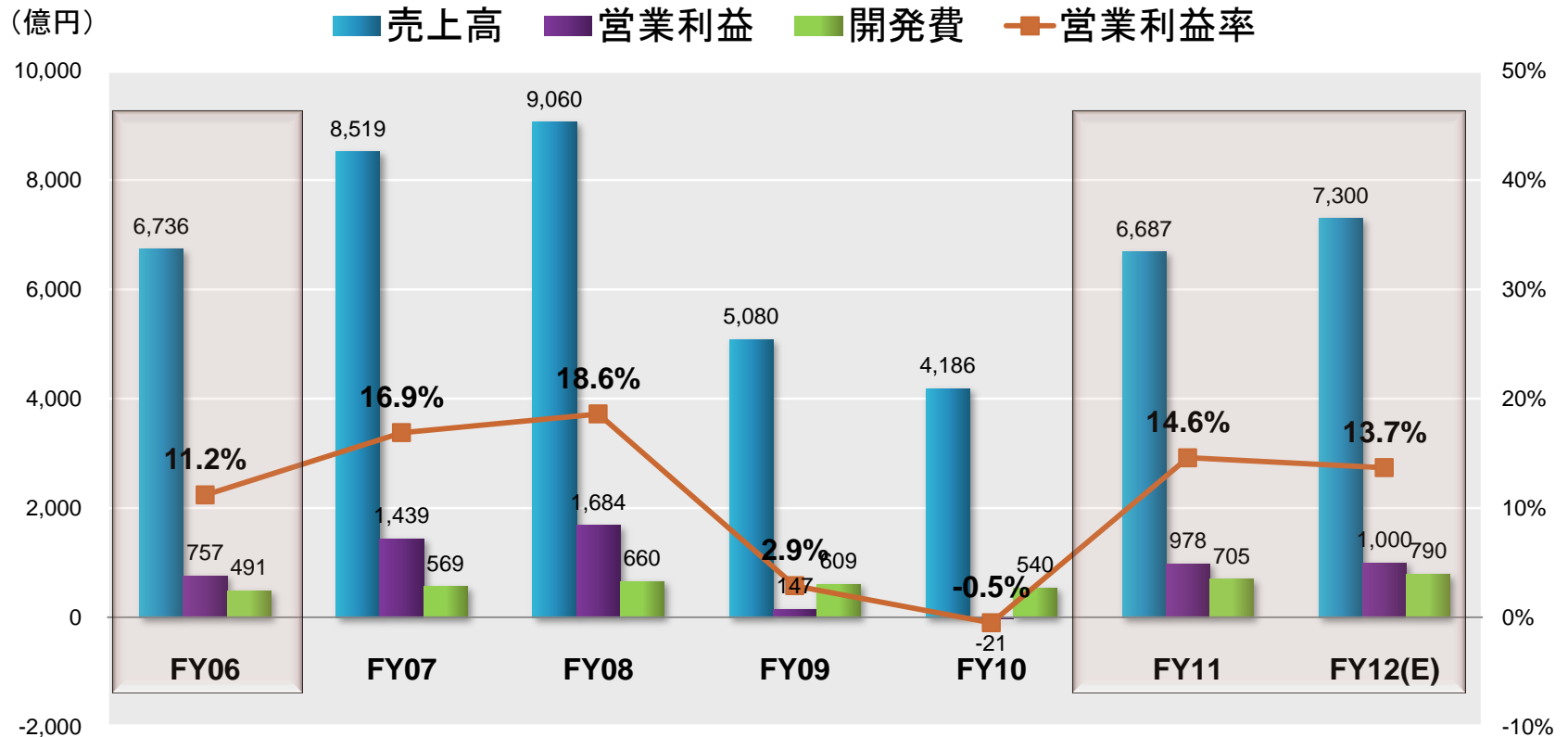
1株当たり配当金 (予想)		
中間配当	期末配当	合計
45円	85円	130円



配当性向35.3%*、増配を見込む

*2011年3月期期末配当より、配当性向を従来の20%目途から35%目途に引き上げました

連結売上高・営業利益率推移



積極的な研究開発を継続させつつ、収益性を改善

経営方針



市場と技術の変化 — SPE

市場の変化

- 顧客の寡占化加速
- モバイル市場拡大によるNAND、ファウンドリー需要増
- 装置のロングライフ化

技術の変化

- 技術の高難度化 — ダブルパターンニング, EUV, 3Dメモリ
- New Solution — 3DI (3次元積層技術)

SPE事業戦略

1. 開発・製造一体化によるエッチャーの強化（宮城新工場）
2. 洗浄装置市場でのポジション向上
3. SPE各装置のプロダクト差別化
4. 新技術（3DI, テストシステム）分野への参入
5. フィールド・ソリューション事業の拡大
6. 顧客との上流からの連携強化



宮城新工場（宮城県大和町）

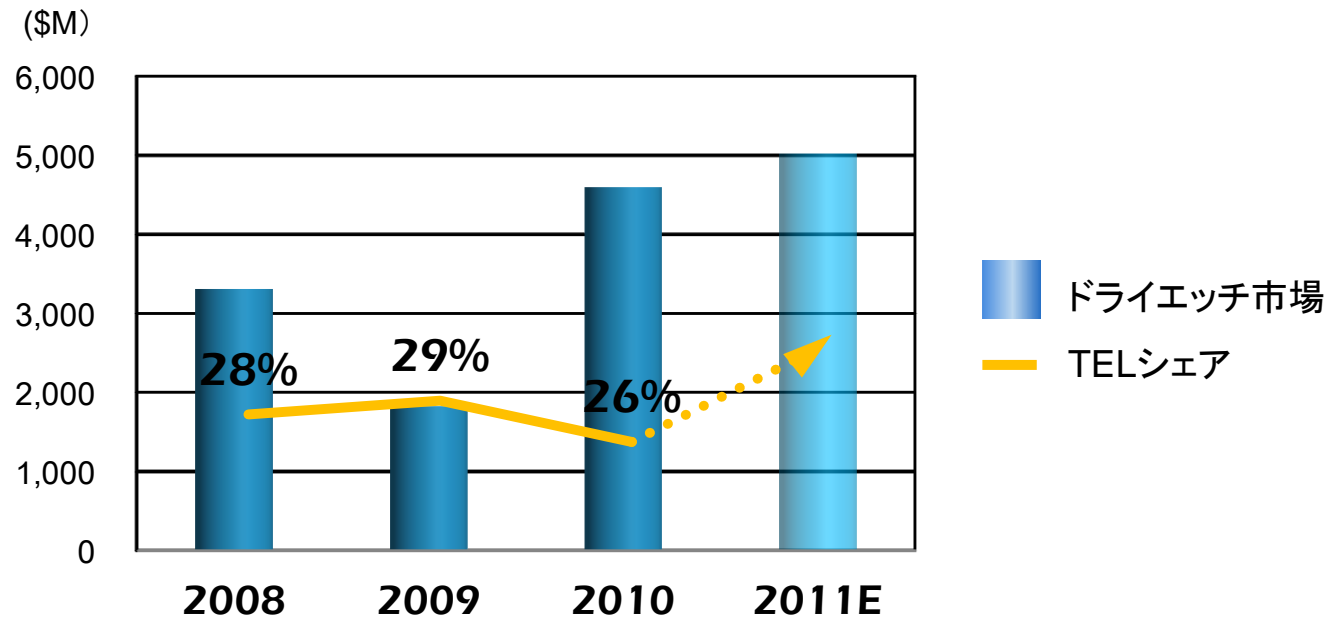


TEL Technology Center,
Taiwan（台湾）



プロセス技術センター（韓国）

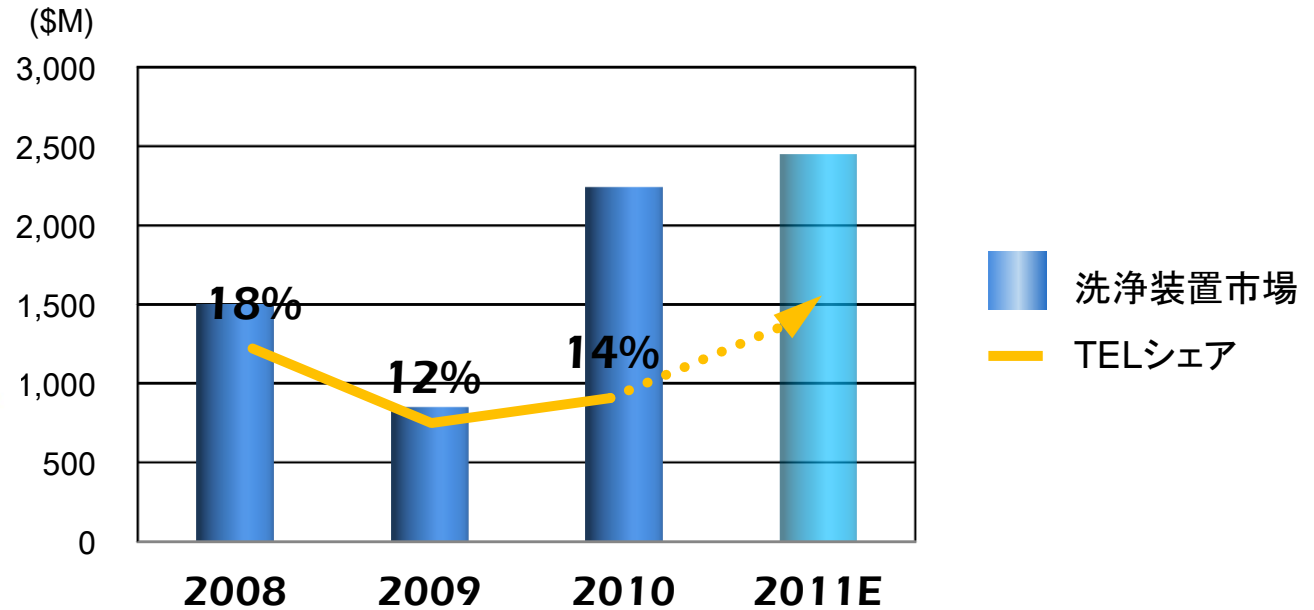
ドライエッチャー



市場規模: Gartner Dataquest, TELシェア: TEL推定

- 2009年比でシェア微減 (背景: メモリー投資比率の上昇)
- 酸化膜エッチ: DRAM向け深穴工程およびロジック向け配線工程でシェア拡大
- シリコンエッチ: 複数顧客から新POR獲得 (RLSAエッチャー含む)
- POR純増数: 20工程以上

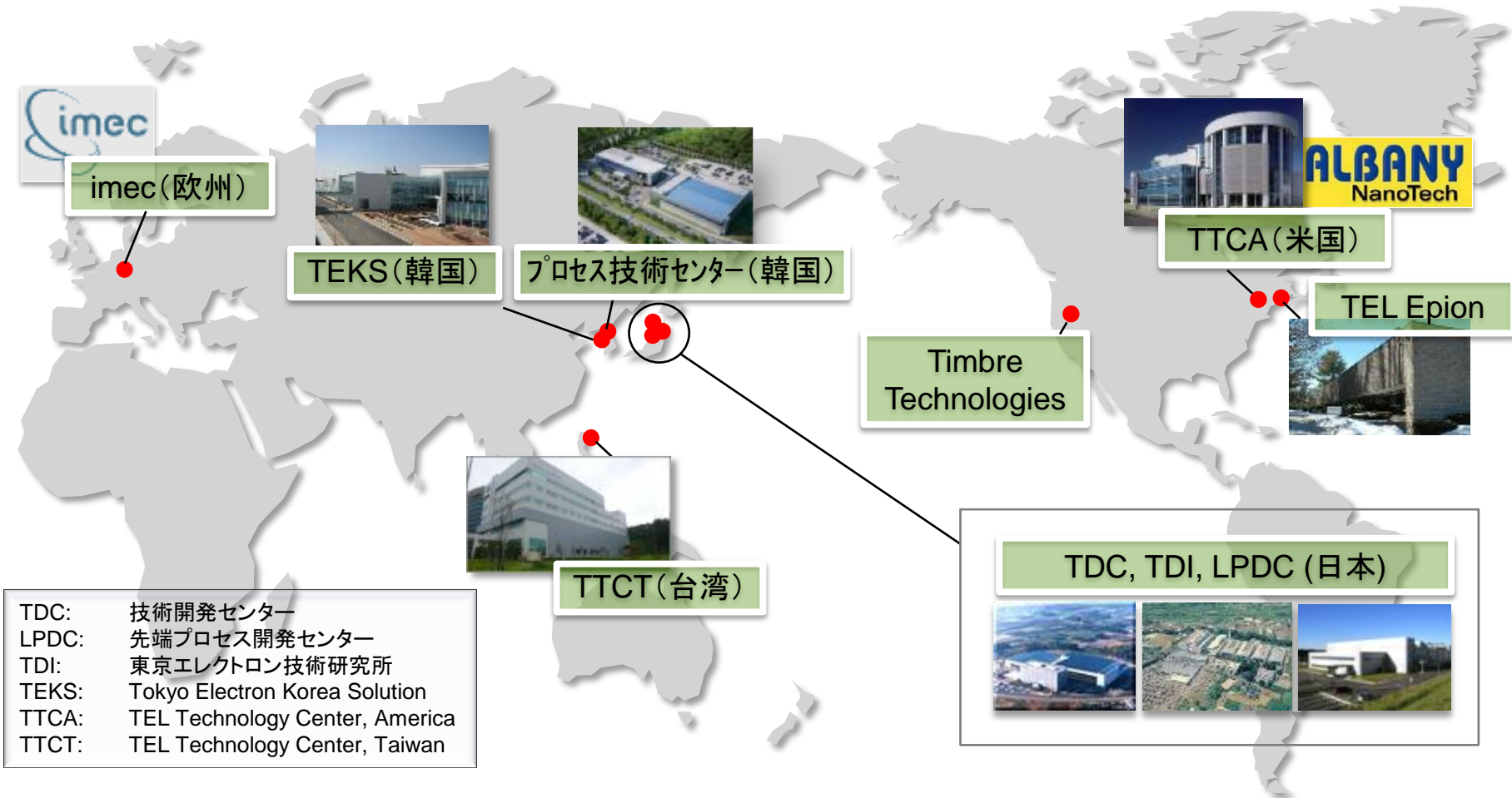
洗淨装置



市場規模: Gartner Dataquest, TELシェア: TEL推定

- 2009年比でシェア微増
- 枚葉洗淨: 複数顧客への評価機導入に成功
- スクラバーシェア40%, ドライ洗淨シェア60%

グローバル開発拠点



先端技術に密着した開発体制の拡充

主要事業 今期のKey Action

コータ／デベロッパ

- Immersion露光機向けシェアの維持、向上
- EUV露光機とのインライン環境での塗布現像技術開発

熱処理成膜

- シェアの拡大、特に韓国市場でのポジション向上
- ALD等新規市場への本格参入によるビジネス基盤の強化

枚葉成膜

- 枚葉メタル成膜分野の幅広いニーズに対応する新製品開発
- Ruを用いたプロセスの認知・確立と量産採用展開

RLSA

- Poly-Etchでの低ダメージプロセスにて拡販加速
- CVDへの技術応用を含めて500億円事業の構築

主要事業 今期のKey Action

3DI

- 複数顧客にてエッチング・成膜・仮貼合わせの評価、採用推進
- 裏面照射型CIS*向けのFusion Bonderの拡販

テストシステム

- 更なる収益体制の強化
- テストコスト低減に応える新たなシステムの開発

フィールド・ソリューション

- 主に汎用デバイス市場の新規投資、増設等に柔軟に対応
- 中古機、改造、保守契約等への積極展開で1,500億円を視野

CIS: C-MOS Image Sensor

市場と技術の変化 — FPD

市場の変化

- TV用大型ディスプレイ向け投資は中国中心
- タッチパネル用中小型ディスプレイ向け投資活況
- 韓国装置メーカーの台頭、コスト競争の激化

技術の変化

- 基板サイズ拡大停滞、中小型比率上昇
- 高精細化、高速化
- ポスト液晶 - 有機ELディスプレイ



中国にFPD製造拠点設立

設立目的

- 顧客への対応力強化
- コスト競争力強化

事業内容

- 中国向けFPD製造装置の電極定期補修
- 将来的には改造および一部既存装置の生産

場所： 中国江蘇省昆山市

着工： 2011年1月

竣工： 2012年1月

総投資額： 約50億円



伸びる有機EL市場への当社の取り組み

蒸着法

当社独自技術

高精度の成膜コントロール

高い有機材料使用効率

省スペース設計

インクジェット法

セイコーエプソンとの協業

1回塗布によるRGB塗分け

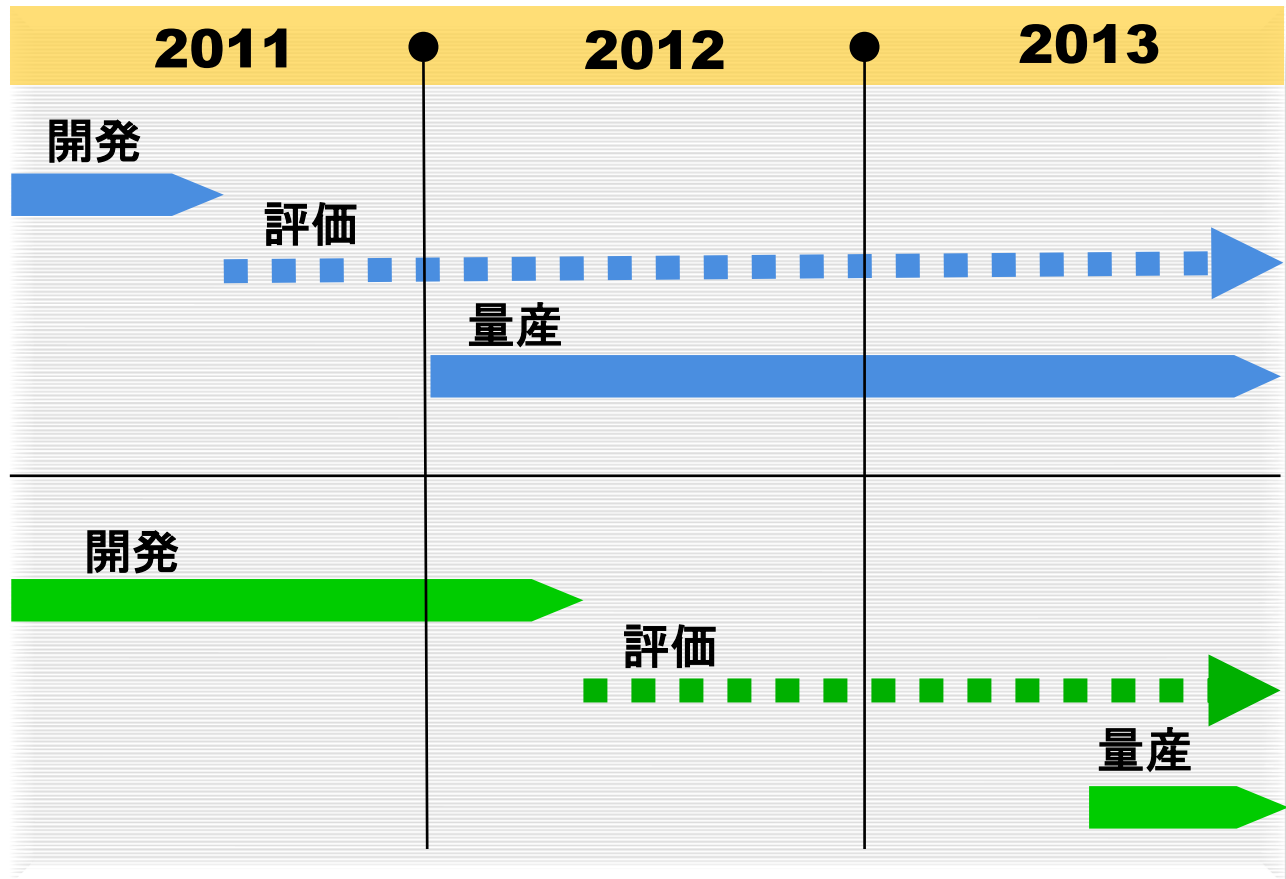
超大型基板サイズ量産実績

高品質な印刷技術

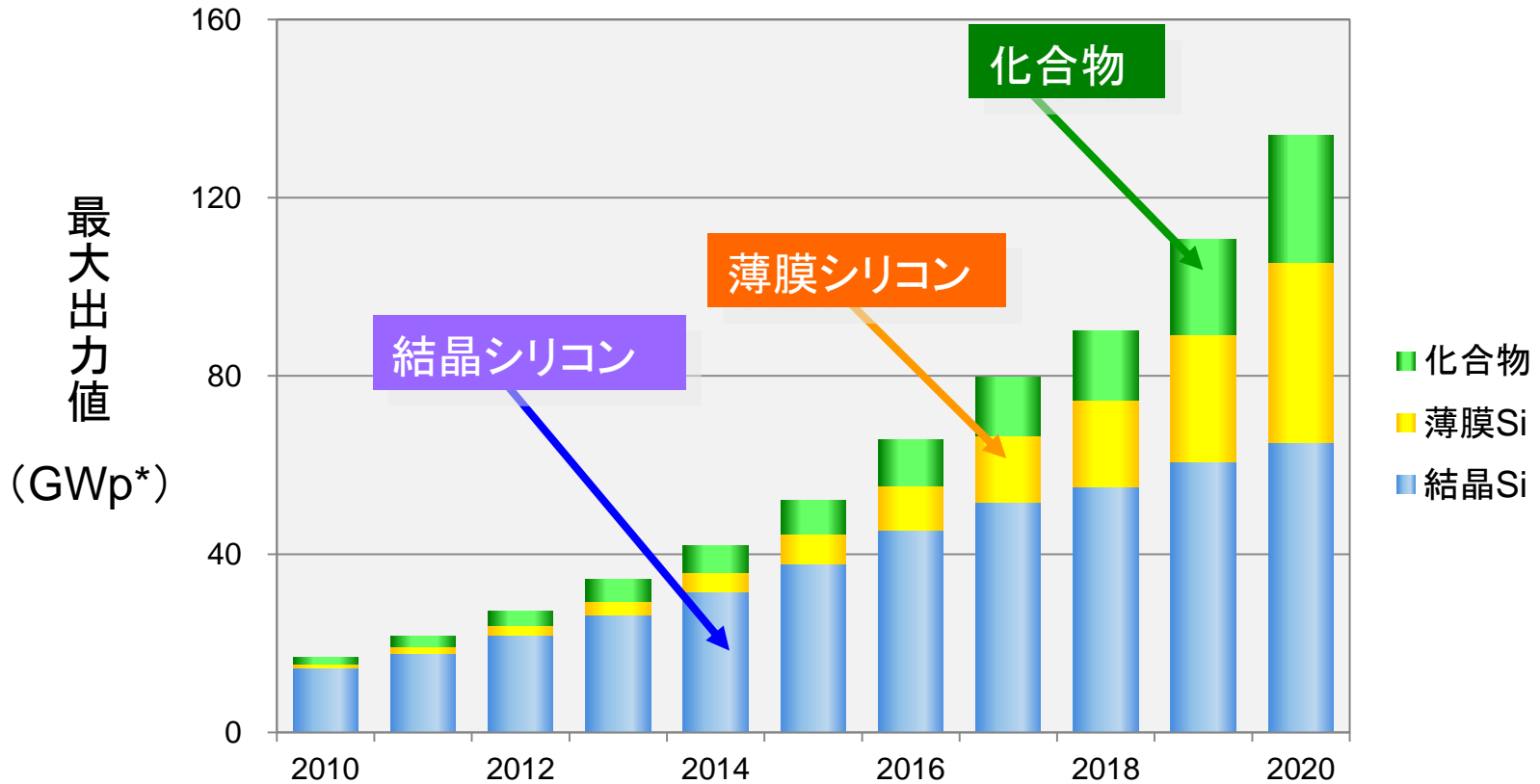
有機ELのロードマップ

蒸着法

インク
ジェット
法



太陽電池市場予測(2010-2020)



GWp (ギガワット・ピーク)は最大出力値の単位 原子炉1基の通常出力値は約1GW
出所: EPIA (European Photovoltaic Industry Association) 発表に基づく 当社予測

PV事業戦略

装置開発

SHARP

日欧への出荷開始

アジア市場開拓

oerlikon
solar

€0.5/wp実現

プロセス開発


TOKYO ELECTRON

TEL独自技術

TELテクノロジーセンターつくば設立

設立目的

- 新たな基盤技術、コア技術の研究開発加速
- 薄膜Si PVEの高効率化技術開発

期待効果

- 日本を代表する研究機関・大学等との有機的連携
- 異業種とのネットワーク交流
- 優秀な人材の採用

場所：茨城県つくば市

着工：2011年8月

竣工：2012年3月

総投資額：約70億円

人員規模：約100名



2012年3月期 まとめ

▶ SPE

既存ビジネスの強化

特にエッチャー、洗浄装置の確実なポジション向上

3DI、テストシステムの事業化推進

▶ FPD、有機EL、PV

中国新工場による競争力強化

中期成長へ向けての先行投資

▶ 各新設拠点の立ち上げ

宮城県大和町、茨城県つくば市、韓国

**当社の持つコア技術と隣接分野の開発を強化し、
技術力、製品力で業界をリードする**

■ 将来見通しについて

本資料に記述されている当社の業績予想、将来予測などは、当社が作成時点で入手可能な情報に基づいて判断したものであり、経済情勢、半導体/FPD/PV市況、販売競争の激化、急速な技術革新への当社の対応力、安全・品質管理、知的財産権に関するリスクなど、様々な外部要因・内部要因の変化により、実際の業績、成果はこれら見通しと大きく異なる結果となる可能性があります。

■ 数字の処理について

記載された金額は単位未満を切り捨て処理、比率は1円単位の金額で計算した結果を四捨五入処理しているため、内訳の計が合計と一致しない場合があります。

■ 為替リスクについて

当社の主力製品である半導体製造装置及びFPD/PV製造装置の輸出売上は、原則円建てで行われます。一部にドル建ての決済もありますが、受注時に個別に先物為替予約を付し、為替変動リスクをヘッジしています。従って、収益への為替レート変動による影響は極めて軽微です。

FPD/PV: フラットパネルディスプレイ及び太陽電池